



2024年3月期

第2四半期決算説明資料

2023年11月8日

TOWA株式会社

主な説明内容

1. 2024年3月期 上期実績
2. 2024年3月期 通期予想
3. TOPICS

主な説明内容

1. 2024年3月期 上期実績
2. 2024年3月期 通期予想
3. TOPICS

2024年3月期 上期サマリー

受注高 268.6 億円	売上高 212.6 億円	営業利益 23.8 億円	経常利益 27.6 億円	当期純利益 19.5 億円
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

▶ **受注高は第2四半期に大幅改善。**

PC、スマートフォンなどの民生品向け投資は調整局面が続いているものの、車載用半導体は前期から堅調であるのに加え、中国での半導体内製化に向けた投資の再加速や生成AI向けのHBMや2.5Dパッケージ向け投資の増加により、受注高は前年同期比で増加。

▶ **各段階利益については予想値を上振れ。**

売上高は概ね予想通りとなったものの、高付加価値製品の増加に伴い、粗利益率が改善したことにより、各段階利益は予想値を上回る。

こちらのスライドは、2024年3月期上期決算のサマリーです。

受注高はPC、スマートフォンなどの民生品向け投資は調整局面が続いているものの、車載用半導体は前期から堅調であるのに加え、中国での半導体内製化に向けた投資の再加速や生成AI向けのHBMや2.5Dパッケージ向け投資の増加により、前年比で増加しました。

予想比では売上高は概ね予想通りとなったものの、高付加価値製品の増加にともない粗利益率が改善した結果、各段階利益は予想値を上回りました。

2024年3月期 上期連結業績結果（前年比）

（単位：億円）

	2023/3期 上期実績	2024/3期 上期実績	増減額	前年比	2024/3期 上期業績予想	予想比
売上高	287.8	212.6	▲ 75.2	▲ 26.1%	210.0	+ 1.3%
営業利益	58.6 (20.4%)	23.8 (11.2%)	▲ 34.7	▲ 59.3%	18.5 (8.8%)	+ 29.1%
経常利益	64.9 (22.5%)	27.6 (13.0%)	▲ 37.3	▲ 57.4%	18.5 (8.8%)	+ 49.4%
当期純利益	47.6 (16.6%)	19.5 (9.2%)	▲ 28.1	▲ 58.9%	12.9 (6.1%)	+ 51.8%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは、上期の業績結果です。

売上高は、PC、スマートフォンなどの民生品向け投資の調整局面が続いていることから前年比で減収となりました。

営業利益につきましては、売上高の減少に伴い、前年比では減益となったものの、期初計画比では製品ミックスの改善や製品価格上昇により、改善いたしました。

詳細については、12ページの増減要因分析をご覧ください。

2024年3月期 上期セグメント別売上高 (前年比)

(単位：億円)

	2023/3期 上期実績	2024/3期 上期実績	増減額	前年比
売上高	287.8	212.6	▲ 75.2	▲ 26.1%
半導体事業	225.2	157.5	▲ 67.7	▲ 30.1%
化成品事業	9.1	10.9	+ 1.8	+ 20.6%
新事業	41.4	32.4	▲ 9.0	▲ 21.8%
レーザ事業	12.1	11.8	▲ 0.3	▲ 2.7%

こちらは、セグメント別の売上高です。

半導体事業は、車載用半導体向けの売上は好調であったものの、PC、スマートフォンなどの民生品向け売上の減少により、前年比で30.1%減となりました。

化成品事業はコロナの5類移行により、一般検査、診断、治療などの回復に伴い、成形品の需要も増加していることから、前年比で20.6%増となりました。

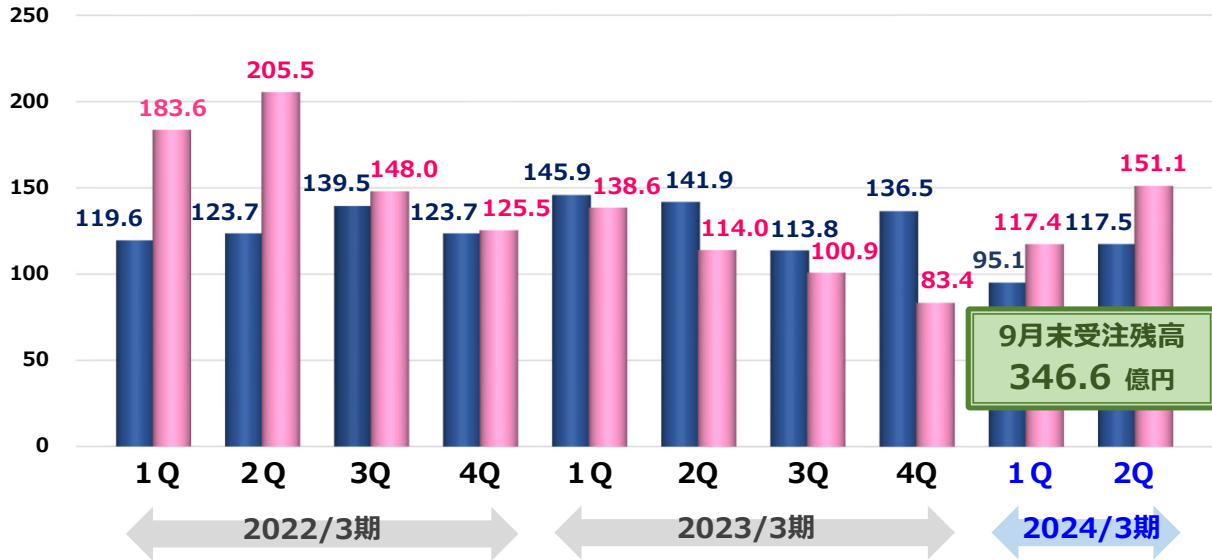
新事業については、前年比21.8%減となりました。主に、半導体市況の悪化により、TSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が前年比で減少したためです。

レーザ事業については、前年比で2.7%減となりました。

受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



7

This material is the property of TOWA CORPORATION

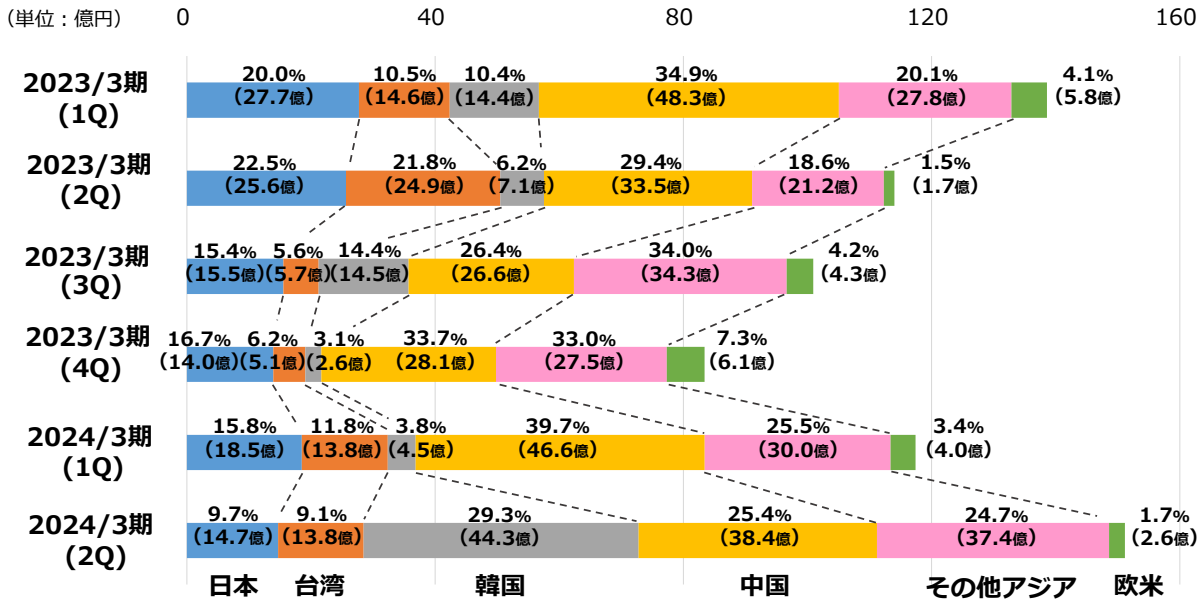
TOWA

こちらは四半期ごとの受注・売上高の推移です。

PC、スマートフォンなどの民生品向けを中心に半導体の設備投資の抑制がつづいていることから1Q、2Qの売上高は低調に推移したものの、概ね予想通りの結果となりました。

受注高は、前期の4Qを底に中国での半導体内製化に向けた投資の再加速や、生成AI関連向けのHBMや2.5Dパッケージ向け投資の増加により、今期1Q、2Qと回復が進みました。

地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）



こちらは地域別の受注高です。金額は仕向地ベースとなっております。

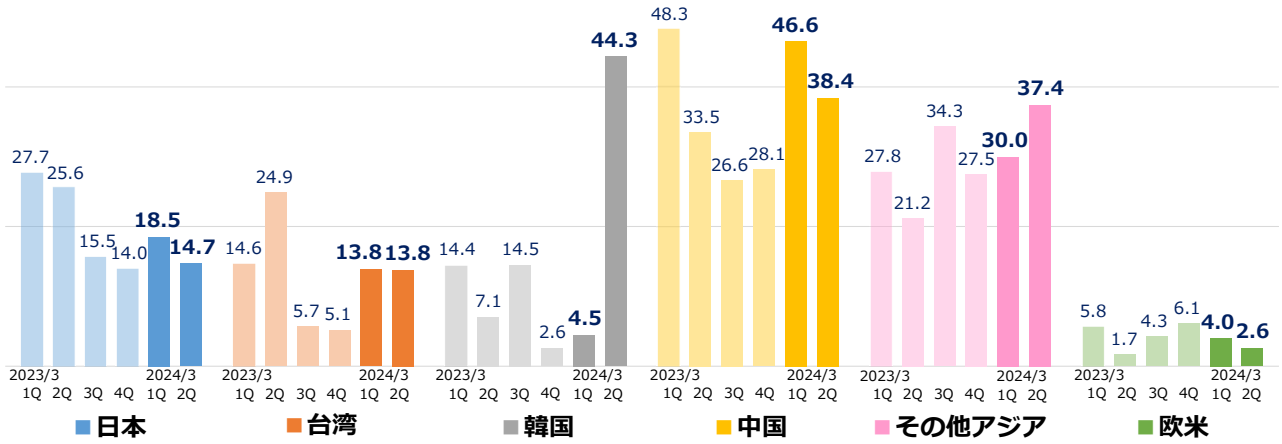
韓国地域において、HBMや2.5Dパッケージ向け装置の受注が急増したことから、2Qの受注が大幅に改善いたしました。

また、その他アジア地域では車載用半導体を中心に堅調な受注が継続しています。

詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

地域別受注高推移（仕向地ベース）

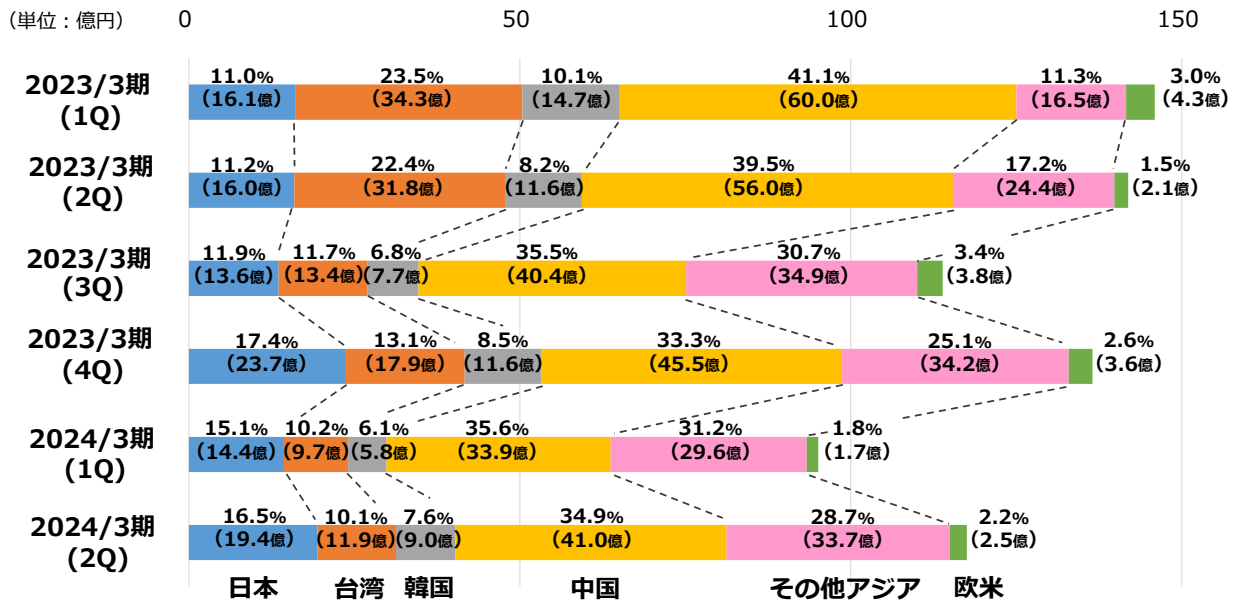
(単位：億円)



こちら地域別の受注高推移について地域ごとにまとめたものです。金額は先ほどのページと同様です。

参考にご参照ください。

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）



こちらは地域別の売上高です。金額は受注同様、仕向地ベースとなっております。

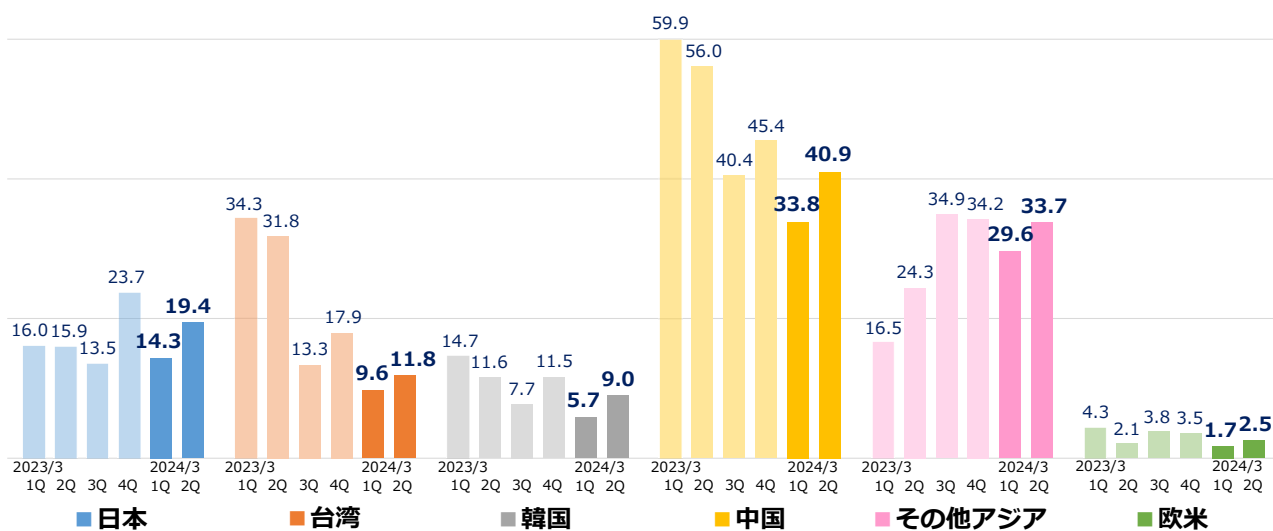
その他アジア地域は地政学的リスクの観点や車載用半導体需要の高まりから堅調に推移しています。

一方、台湾や韓国はメモリを中心に、PC、スマートフォンなどの民生品向け投資の減少により、低調な売上となっております。

こちらにも、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

地域別売上高推移（仕向地ベース）

（単位：億円）

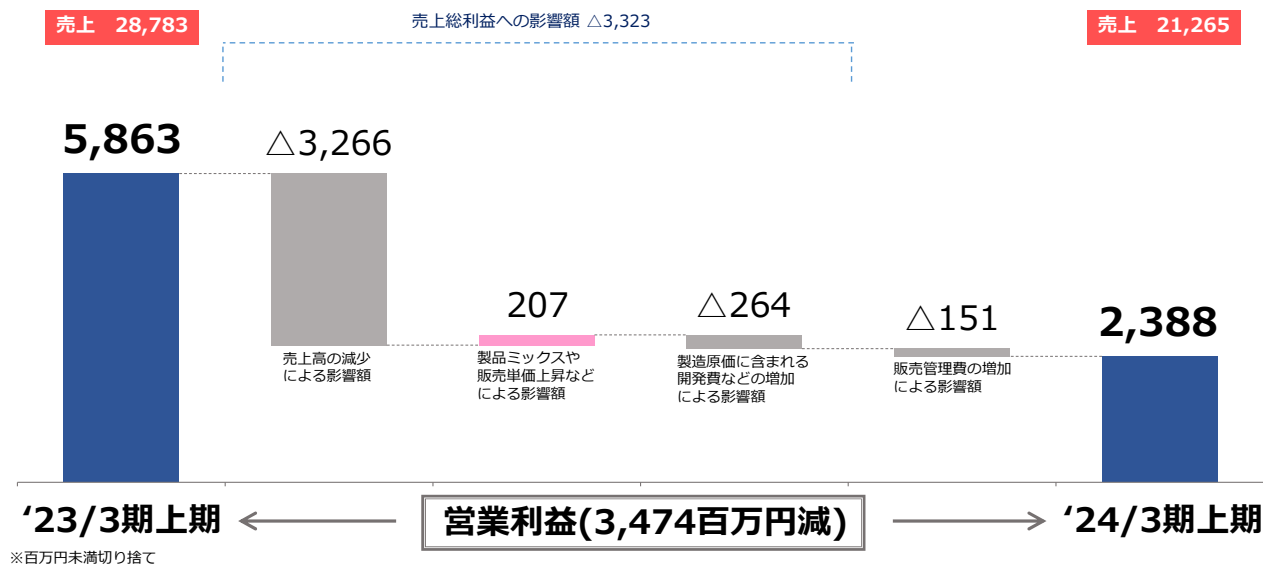


こちら地域別の売上高推移について地域ごとにまとめたものです。金額は先ほどのページと同様です。

参考にご参照ください。

2024年3月期上期 連結営業利益 増減要因分析

(単位：百万円)



こちらは、前期上期と今期上期の営業利益の増減要因分析です。

参考としてご覧ください。

主な説明内容

1. 2024年3月期 上期実績
2. 2024年3月期 通期予想
3. TOPICS

2024年3月期 通期 連結業績予想

※期初予想から変更なし

(単位：億円)

	2024/3期 上期実績	2024/3期 通期予想	2023/3期 通期実績	前年比 上段:増減額、下段:増減率
売上高	212.6	510.0	538.2	▲28.2 ▲5.2%
営業利益	23.8 (11.2%)	81.6 (16.0%)	100.3 (18.6%)	▲18.7 ▲18.7%
経常利益	27.6 (13.0%)	81.6 (16.0%)	102.0 (19.0%)	▲20.4 ▲20.0%
当期純利益	19.5 (9.2%)	57.1 (11.2%)	73.4 (13.6%)	▲16.3 ▲22.3%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

ここからは、通期の業績予想についてです。

上期実績につきましては、予想を上振れしたものの、PCやスマートフォンなどの民生品需要の回復が遅れており、先行き不透明な状況から、通期予想は期初予想を据え置いています。

PCやスマートフォンなどの最終製品需要の低迷が長引いているものの、9月末時点の受注残高は346.6億円あり、生産計画等にも大きな変更はないことから、売上高、各段階利益ともに通期予想を据え置いています。

今後の市場見通しの詳細につきましては、16ページをご覧ください

2024年3月期 セグメント別売上高計画

※期初予想から変更なし

(単位：億円)

	2024/3期 上期実績	2024/3期 通期予想	2023/3期 通期実績	前年比 上段:増減額、下段:増減率
売上高	212.6	510.0	538.2	▲28.2 ▲5.2%
半導体事業	157.5	370.6	412.7	▲42.1 ▲10.2%
化成品事業	10.9	20.0	19.5	+0.5 +2.5%
新事業	32.4	93.4	80.1	+13.3 +16.6%
レーザ事業	11.8	26.0	25.9	+0.1 +0.5%

こちらは、セグメント別の業績予想となります。

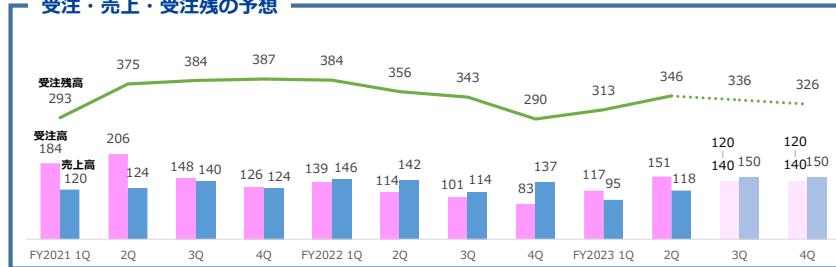
こちらも期初予想からの変更はありません。

今後の市場見通し

今後の市場見通し

- PC、スマートフォンなどの民生品向け投資は調整局面が続く。本格的な回復は2025年3月期2Q頃を見込む。
- 生成AI関連向け装置需要は2024~2025年にかけて本格化を見込む。
- 2025年3月期は生成AI関連向け装置納入の本格化や民生品向け投資の再開により、業績回復を見込む。第一次中期経営計画の最終目標売上高600億円、営業利益126億円を目指す。

受注・売上・受注残の予想



受注高予想

3Q 120-140億円 4Q 120-140億円

損益予想

(前回予想据え置き)

売上高 510億円
 営業利益 81.6億円
 経常利益 81.6億円
 当期利益 57.1億円

こちらは、今後の市場見通しについてです。

PC、スマートフォンなどの民生品向け投資の調整局面が下期も続くと予想され、本格的な回復は2025年3月期2Q頃を見込んでいます。また、投資が増加してきているHBMや2.5Dパッケージなど生成AI関連向け装置需要は2024~2025年にかけて本格化すると見込んでいます。

2025年3月期は生成AI関連向け装置納入の本格化や民生品向け投資の再開に伴い、業績回復を見込んでおり、第一次中期経営計画の売上高600億円、営業利益126億円を目指して、取り組んでまいります。

2024年3月期 配当計画

	2023/3期 実績	2024/3期 計画
配当	40.0円	40.0円

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、40.0円に変更なし。
なお、中間配当は見送りとさせていただきます。

こちらは、今期の配当計画になります。

2023年5月に発表しました計画から変更はありません。

主な説明内容

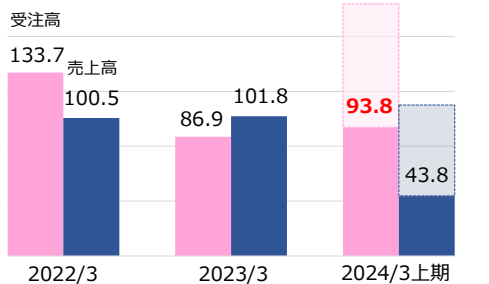
1. 2024年3月期 上期実績
2. 2024年3月期 通期予想
3. **TOPICS**

生成AI関連とTOWA①

生成AI関連（HBM、2.5D等）向け装置の需要が増加

- 生成AIの普及によりHBM向けや2.5Dパッケージ向けにコンプレッション装置の受注が増加。上期だけで前期通期のコンプレッション装置受注を超える。

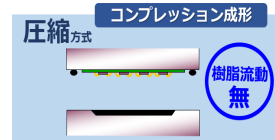
コンプレッション装置※ 受注高・売上高の推移



※装置・金型含む

TOWAの独自のコンプレッション技術

- 樹脂流動がないためチップやワイヤへのダメージ無し（薄型、積層、モジュール化されたパッケージに最適）
- 独自技術により、狭ギャップ成形が可能
- 大判化されたパッケージにも対応可能(コストダウン)
- 樹脂使用効率100%(廃棄ゼロ)



生成AIとTOWAの関連性についてです。

生成AIの普及に向けて、今期2QよりHBM（超広域帯メモリ）向けや2.5Dパッケージ向けにコンプレッション装置の受注が大幅に増加しました。コンプレッション装置の受注高は今期の上期だけで、前期通期の受注高を超過いたしました。

TOWA独自のコンプレッション技術は樹脂流動がないため、チップやワイヤのダメージがなく、薄型、積層、モジュール化されたパッケージに最適な技術です。また、基板を樹脂に漬け込む独自の方式により、狭ギャップへの樹脂充填も可能な技術となっています。

HBM生産時の優位性については、次のスライドで説明いたします。

生成AI関連とTOWA②

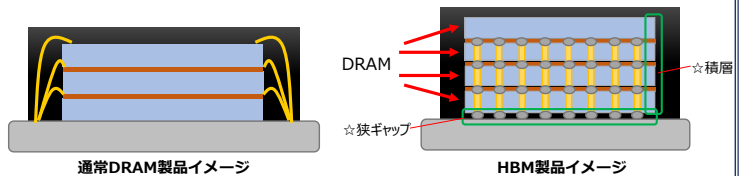
HBM向けコンプレッション装置の優位性

- 生成AI用半導体に必須となるHBMの量産に当社装置が採用される
- ▶ 当社独自のコンプレッション技術が積層された製品に最適



WLP向けコンプレッション装置
CPM1080

通常のDRAM製品とHBM製品との比較



コンプレッション技術の優位性：狭ギャップ成形、積層化

→ コンプレッションの特徴がHBM向けモールドに最適！！

生成AI用半導体に必須となる最新HBMの生産に当社コンプレッション装置が採用されている理由について、簡単にご説明いたします。

通常のDRAM製品に比べ、HBM製品は積層化が進んでいることや狭ギャップ成形が求められています。

前のページでも述べたように、コンプレッション技術は積層されたチップの成形や狭ギャップ間への樹脂充填に対応可能な技術となっていることから、HBM生産用モールド装置にはTOWAのWLP（ウエハーレベルパッケージ）向けコンプレッション装置が採用されています。

生成AI関連とTOWA③

チップレット製品に対応した業界初の装置

● 新製品「YPM1250-EPQ」の開発完了

▶ 新たなモールディング技術（レジンフローコントロール方式）を採用

- 新たな金型構造と独自の真空技術により樹脂の流れを制御



- 生成AIや高機能AI向けのチップサイズが大きいチップレット製品に最適

独自技術の開発により、半導体の高機能化に貢献



続きまして、チップレット製品向けに対応した新製品についてです。

TOWAは、チップレット製品に対応した業界初の新製品「YPM1250-EPQ」の開発を完了させました。

新たな金型構造により、樹脂の流れを制御するモールディング技術「レジンフローコントロール方式」を開発し、本製品に採用しています。

この「レジンフローコントロール方式」により、新製品「YPM1250-EPQ」は生成AIや高機能AI向けのチップサイズが大きいチップレット製品に最適な装置となっています。

TOWAはこれからも独自技術の開発により、半導体の高機能化に貢献していきます。

詳細は2023年9月26日に発表しましたリリースをご覧ください。

<https://www.towajapan.co.jp/jp/news/2023/ir/20230926/>

その他トピックス

シングュレーション事業本部発足

開発～営業・サービスまでを行う専門体制

シングュレーション事業の拡大に向け、2023年10月に開発・製造・営業・サービスを一貫して行うべく、シングュレーション事業本部を立ち上げました。専門体制による、顧客対応の迅速化や営業体制強化により、シェア奪還を目指してまいります。



医療品組立用のクリーンルーム増設

化成品事業拡大に向けた事業強化

化成品事業における新規顧客の拡大が続いており、当社子会社のバンディックにおいて、医療用プラスチック製品の成形から組立を行うことができるクリーンルームの増設を進めています。化成品事業は2032年度に約40億円の売上高を目標としています。



2023年12月末完成予定

TOWA Technology Exhibition 開催

TOWA独自の技術展を5年ぶりに開催

TOWAの技術や新製品、新たな取り組みなどを実機やパネルで紹介する独自技術展をマレーシア工場および本社工場で開催。



日程

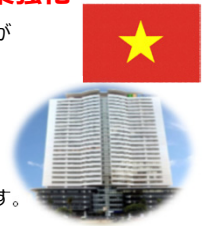
マレーシア工場：9月25日～10月20日（開催済み）

本社工場：12月5日～1月31日（予定）

ベトナム事務所開設

東南アジアでの事業強化

韓国企業を中心に半導体メーカーの進出が進むベトナムにおいて、営業・サービス体制を強化するために当社子会社のTOWA韓国の営業事務所を新設いたしました。ベトナムを含め、半導体メーカー各社の進出が進む東南アジアでの事業拡大に向けて、引き続き、取り組んでまいります。



その他のトピックスについてです。

シングュレーション事業の拡大に向けて、2023年10月にシングュレーション事業本部を立ち上げました。開発～営業・サービス体制を専門部署により、一貫して行い、営業体制や顧客対応を強化し、シェア奪還を目指してまいります。

化成品事業につきましては、新規顧客の拡大が続いており、現在、医療用プラスチック製品の成形から組立を行うことができるクリーンルームの増設工事を進めており、2023年12月末完成予定となっています。

「TOWAビジョン2032」の目標達成に向けて、化成品事業も引き続き、事業強化に向けた取り組みを行ってまいります。

TOWA独自の技術展「TOWA Technology Exhibition」を本社工場およびマレーシア工場で開催いたします。国内外のお客様を招待し、TOWAの技術や新製品、新たな取り組みなどを実機やパネルで紹介する予定です。

韓国企業を中心に半導体メーカーの進出が進むベトナムにおいて、営業・サービス体制を強化するために当社子会社のTOWA韓国の営業事務所を新設いたしました。ベトナムを含め、半導体メーカー各社の進出が進む東南アジアでの事業拡大に向けて、引き続き、取り組んでまいります。

「JPX 日経中小型株指数」構成銘柄選定

JPX総研及び日本経済新聞社が共同で算出する「JPX 日経中小型株指数」の2023年度（2023年8月31日～2024年8月29日）の構成銘柄として選定されました。構成銘柄の選定は、時価総額によるスクリーニングに加え、3年平均ROEなどの定量的な指標による評価、独立社外取締役の選任などの定性的な指標による評価をもとにおこなわれ、200銘柄が選定されています。



マスコットキャラクター「トワッピー」誕生

2022年3月に掲げた長期ビジョン「TOWAビジョン2032」達成に向けたメッセージを広く内外に発信するため、キャラクター「トワッピー」の制作とビジュアルコンセプトメッセージ「Happy Tech Happy World」を制定いたしました。「トワッピー」も活用しながら、TOWAの知名度向上に努めてまいります。



会社案内更新（日・英）

外部へのアピール強化に向けて、会社案内ビデオ・パンフレットを更新いたしました。当社HP上でも公開していますので、ぜひご覧ください。



<ご参考>

<https://www.towajapan.co.jp/company/movie/>

「TOWA統合報告書 2023」発行（日・英）

当社は、財務・非財務情報を統合的に発信するために、マテリアリティの情報も盛り込んだTOWA初の統合報告書「TOWA統合報告書 2023」を発行いたしました。当社HP上で公開していますので、ぜひご覧ください。

<ご参考> 【TOWA統合報告書 2023】

<https://www.towajapan.co.jp/ip/ir/corporatereport/>

こちらはその他PRについてです。

TOWAは、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経中小型株指数」の2023年度の構成銘柄として、選定されました。

「JPX日経中小型株指数」は、「投資者にとって投資魅力の高い会社」を構成銘柄とする「JPX日経インデックス400」と同じコンセプトを中小型株に適用し、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業を選定するものです。今後も皆さまのご期待にお応えできるよう、さらなる成長と企業価値向上を目指してまいります。

2023年8月にマスコットキャラクター「トワッピー」を発表いたしました。長期ビジョン実現に向けて、採用などの人財確保や、BtoCを視野に入れた新たな事業展開を見据えて、「トワッピー」も活用し、知名度の高い会社を目指してまいります。

また、会社案内ビデオ・パンフレットの更新やTOWA初となる統合報告書を発行しました。HP上でも公開していますので、ぜひご覧ください。

T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。

参考資料



会社概要

会社名	TOWA株式会社
事業内容	半導体・LED製造装置、超精密金型、 ファインプラスチック成形品、レーザー加工装置
設立	1979年4月
代表者	代表取締役社長 岡田 博和
従業員数	1,977名(連結) [2023年9月末]
資本金	89億円
証券コード	6315
所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地

事業内容

新事業

- ・TSS (トータルソリューションサービス)
- ・精密加工用工具、受託加工
- ・微細加工
- ・コーティング



化成品事業

- ・ファインプラスチック成形品
- ・医療機器



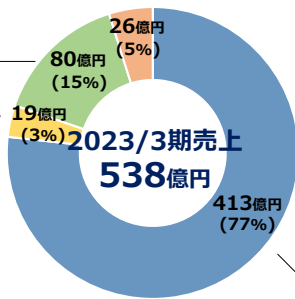
レーザー加工装置事業

- ・レーザトリマ
- ・ウェハーマーカ
- ・レーザ溶接機



半導体事業

- ・半導体製造用精密金型
- ・半導体製造用モルディング装置
- ・半導体製造用シンギュレーション装置



生産拠点

● TOWA ● グループ会社

韓国

- TOWA韓国株式会社
- TOWAファイン株式会社

半導体製造装置、精密金型、部品の製造

ブレードの製造



中国

- TOWA半導体設備（蘇州）有限公司

半導体製造装置、精密金型の製造



- 東和半導体設備（南通）有限公司

半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

- TOWAM Sdn. Bhd.
- TOWA TOOL Sdn. Bhd.

半導体製造装置の製造

半導体製造用金型の製造



京都

- 本社・工場（京都市）

半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

- 京都東事業所（宇治田原町）

半導体製造用金型の製造



佐賀県（鳥栖市）

- 九州事業所

半導体製造用金型の製造



山梨県（韮崎市）

- 株式会社バンディック

ファイナプラスチック成形品の製造



神奈川県（相模原市）

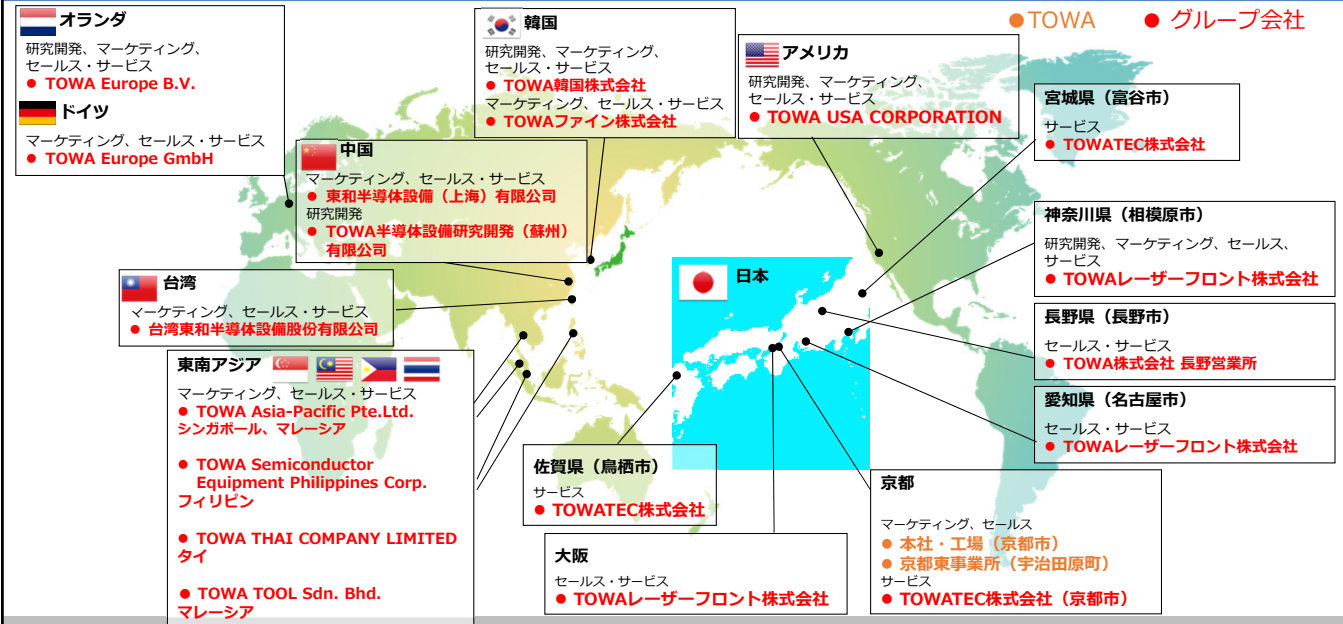
- TOWAレーザーフロント

株式会社

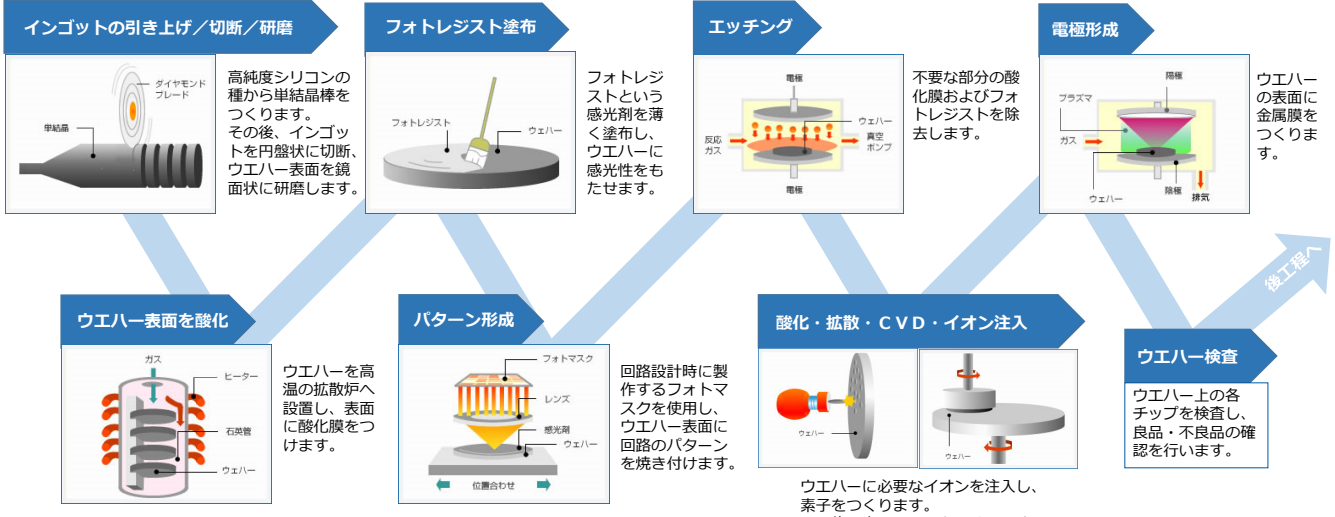
レーザー及びレーザー加工装置の開発、製造

販売・サービス拠点

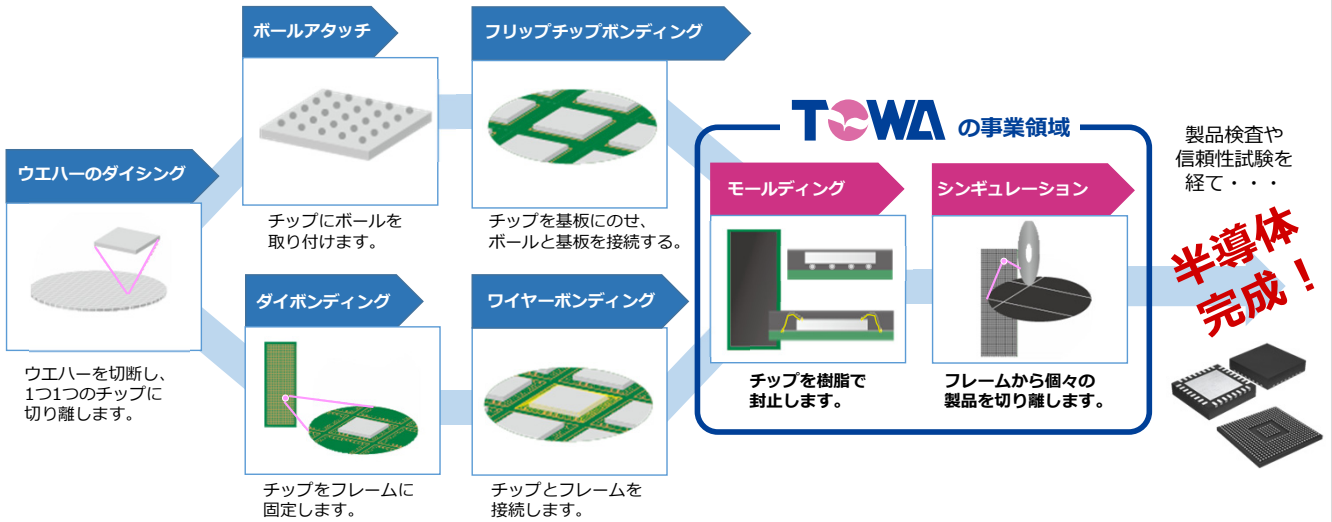
● TOWA ● グループ会社



半導体が出来るまで - 前工程 -

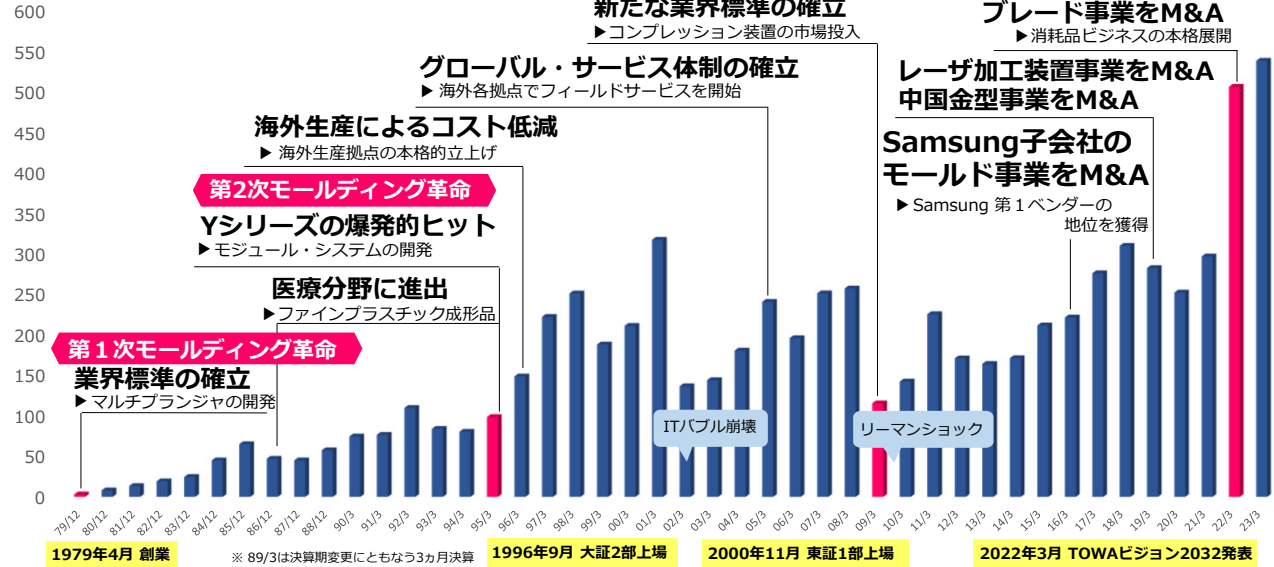


半導体が出来るまで - 後工程 -



TOWAの歩み

(億円)



1979年4月 創業

※ 89/3は決算期変更にとまらう3ヵ月決算

1996年9月 大証2部上場

2000年11月 東証1部上場

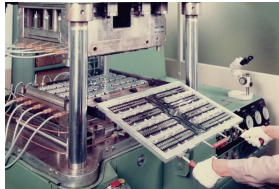
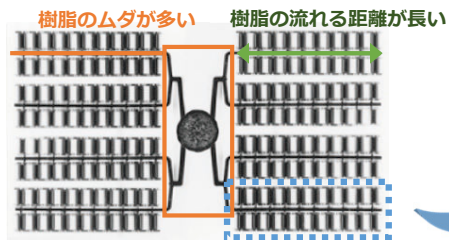
2022年3月 TOWAビジョン2032発表



第1次モールドイング革命(1979年)

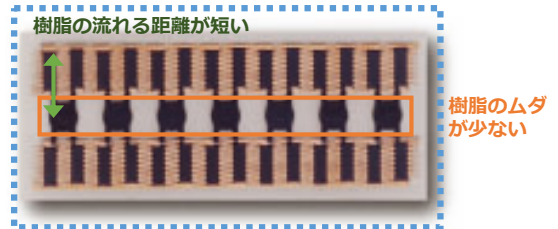
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く成形品質にバラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く成形品質が向上し**、**樹脂のムダが少ない**。



第2次モールドイング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドイング装置は・・・

- ・一品一様であり、生産する製品毎に装置を買い替え
- ・生産量に応じて複数の装置を保有する必要がある



モジュールシステムによりプレスが増減が可能に!!

- ・Yシリーズだけで様々な製品の生産が可能
- ・生産量に応じて追加で設備投資が可能

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドイング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

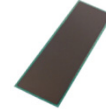
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで他社の追随なし。

特 徴

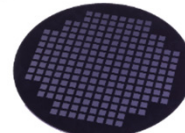
- ・樹脂使用効率**100%**（CO2排出量約**70%**削減）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（不良品が少ない）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



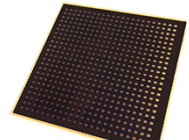
PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



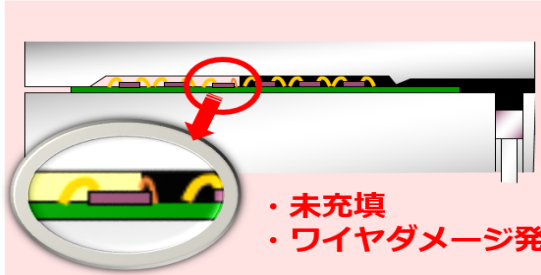
パネルサイズ
600mm×600mm

半導体パッケージへのソリューション

トランスファー成形

注入方式

樹脂流動
有

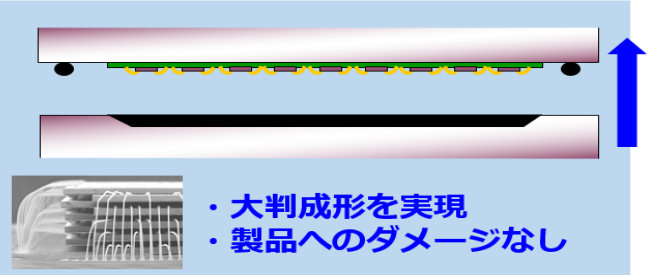
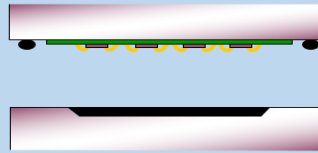


- ・未充填
- ・ワイヤダメージ発生

コンプレッション成形

圧縮方式

樹脂流動
無



- ・大判成形を実現
- ・製品へのダメージなし

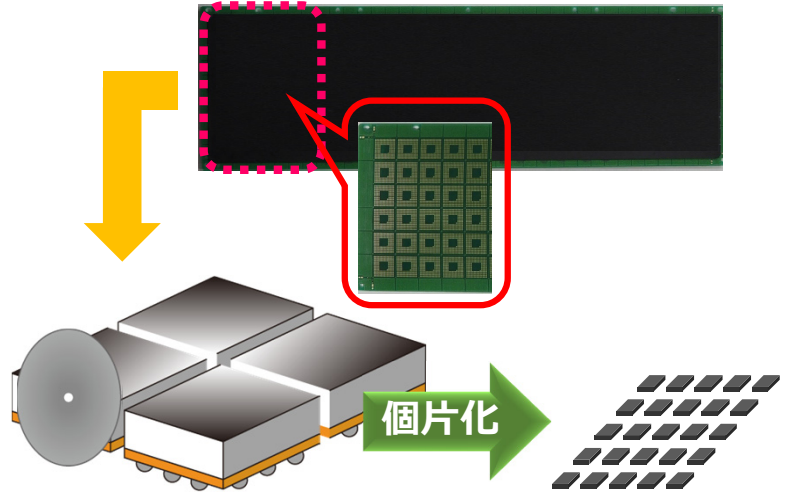
シングルレーションプロセス

モールドイング後、1つ1つの半導体に個片化する

業界最小!
1.0×1.0mmの
個片化が可能



FMS4040



半導体製造装置ラインナップ

～ Compression Mold ～

CPM 1180



Work max size: 625x620mm

CPM 1080



Work max size: ϕ 300mm、320x320mm

PMC 2030-D



Work max size: 100x300mm

～ Transfer Mold ～

YPM 1180



Work max size: 100x300mm

～ Singulation ～

FMS4040



Work max size: 100x300mm